

## Market News

### **CoolMOS™ CE im SOT-223-Gehäuse als preiswerte Komponente für den DPAK-Ersatz**

München, 11. März 2016 – Die Infineon Technologies AG erweitert das Portfolio der CoolMOS™ CE-Familie um ein SOT-223-Gehäuse. Dieses ist eine kosteneffiziente Alternative zum DPAK-Gehäuse. In einigen Anwendungen mit geringer Verlustleistung kann sogar Bauraum eingespart werden. Ohne mittleren Pin ist die Grundfläche des SOT-223-Gehäuses vollständig kompatibel mit dem DPAK und kann als Austauschkomponente hierfür verwendet werden. Das neue Gehäuse eignet sich daher insbesondere für Anwendungen im Bereich LED-Beleuchtung und mobile Ladegeräte.

#### **Kostengünstiger und Pin-kompatibler Ersatz für DPAK**

Das neue SOT-223-Gehäuse ist für den Einsatz in preissensitiven Anwendungen gedacht, bei denen Kostenreduktion im Vordergrund steht. Kosteneinsparungen werden durch das kleinere Gehäuse ermöglicht, das auf der Grundfläche der etablierten DPAK-Gehäuse platziert werden kann. Der Hochvolt-CoolMOS in einem SOT-223-Gehäuse erlaubt damit den Pin-kompatiblen Ersatz von DPAK-Lösungen in fast allen Designs. Und das, ohne wesentliche thermische Nachteile, wenn für das SOT-223 die DPAK-Grundfläche genutzt wird.

Das thermische Verhalten des CoolMOS-Chips in einem SOT-223-Gehäuse wurde für mehrere Applikationen bewertet. Im Vergleich zum DPAK-Gehäuse lag die Temperatur maximal 2-3 °C höher, wenn das SOT-223 auf der Grundfläche eines DPAK-Gehäuses montiert war. In Designs, bei denen die Leistungsdichte optimiert und die thermischen Anforderungen weniger kritisch sind, lässt sich mit dem neuen Gehäuse Platz sparen.

#### **Produktinformation**

Infineon bietet weltweit das erste vollständige Portfolio für Hochvolt-MOSFETs in einem SOT-223-Gehäuse, mit dem die Gesamtkosten sinken. Der CoolMOS ist mit 500, 600, 650 und 700 V im SOT-223-Gehäuse erhältlich. Weitere Informationen zum SOT-223-Gehäuse und zur CoolMOS CE-Familie sind erhältlich unter [www.infineon.com/SOT-223](http://www.infineon.com/SOT-223).